

信息披露 Disclosure

广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票预案

二〇一五年六月

广东德豪润达电气股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

投资者如有任何疑问，应咨询自己股票经纪经纪人、律师、专业会计师事务所或其他专业顾问。

本预案所述本非公开发行股票募集资金的使用和完成将取得中国证监会监督管理委员会等有关监管机构核准。中国证监会监督管理委员会及其授权机构对本次非公开发行股票所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的权益做出实质性判断或保证。

特别提示

- 广东德豪润达电气股份有限公司本次非公开发行股票的相关事项已经第五届董事会第十一次会议决议通过，与本次发行相关的决未决事项，公司将召开召开董事会审议，并做出补充决议。
- 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》，按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2012-2014）》的规定，根据公司未来的发展规划及资金状况，2014年度拟以公司年末股本总额139,640万股为基数，每10股派发现金股利3.0元（含税），共计派发现金股利1,892.0万元（含税）。2014年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者和其他机构投资者，个人投资者等不超过10名（含10名）。特定投资者，证券投资基金管理人管理的全部以上基金认购时，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份，其中单个认购对象及其关联方一致行动人认购数量合计不超过25,000万股，超过部分的认购为无效认购。
- 本次非公开发行的发行对象的数量不超过37,847万股（含37,847万股），募集资金总额不超过450,000万元，定价基准日为第五届董事会第十一次会议决议公告日（即2015年6月13日），根据发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%的规定，本次发行价格定为不低于11.89元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照相关法律法规的规定和监管部门的的要求，根据竞价结果由公司董事会议与保荐机构（主承销商）协商确定。
- 本次非公开发行的股票在发行结束之日起12个月内不得转让。
- 本次非公开发行股票所募集的资金在发行完成后，由新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
- 募集资金投向：公司董事会议可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行股票募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。
- 本次非公开发行股票募集资金总额不超过450,000万元，拟用于以下投资项目：

序号	项目名称	计划投资（万元）	拟用募集资金投入（万元）
1	LED封装芯片项目	260,000	200,000
2	LED芯片封装项目	150,000	150,000
3	补充流动资金	100,000	100,000
	合计	500,000	450,000

- 本次非公开发行股票的发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。
- 本次非公开发行股票在发行完毕后，不会导致公司股权结构不符合上市条件。
- 本次发行募集资金的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。
- 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司信息披露有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规则，公司董事会、股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，就《公司章程》中利润分配政策作出了修订。此外，公司制定了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，有待公司董事会审议通过。关于公司现行的利润分配政策、公司最近三年的现金分红情况、公司未来股东回报规划情况，请详见本预案“第五节利润分配政策及执行情况”，请投资者予以关注。
- 本次非公开发行股票符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

释义

在本预案中，除非文另有所指，下列简称具有如下含义：

公司/本公司/德豪润达电气股份有限公司	指	广东德豪润达电气股份有限公司
董事会	指	本公司董事会
股东大会	指	本公司股东大会
德豪润达半导体	指	本公司子公司德豪润达半导体有限公司
大瀚光电	指	本公司子公司大瀚光电材料科技有限公司
控股股东/芜湖德豪投资有限公司	指	芜湖德豪投资有限公司，及前身为芜湖德豪电器有限公司
本预案	指	广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票预案
本次发行/本次非公开发行	指	广东德豪润达电气股份有限公司本次以非公开发行的方式定向对象发行A股股票的行为
元/万元、百、千	指	人民币元、万元
定价基准日	指	本次非公开发行股票董事会决议公告日
LED	指	LED(light Emitting Diode),发光二极管，简称LED，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它可以直接将电转化为光。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况
广东德豪润达电气股份有限公司
英文名称:EDC-TECH INTERNATIONAL CO., LTD.
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:德豪润达
公司股票代码:002005
成立时间:1996年5月14日
注册地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号
办公地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号
邮政编码:519085
联系电话:0756-3390188
传真号码:0756-3390238
国际互联网网址:www.edctech.com.cn
公司电子邮箱:002005dngm@edctech.com.cn
法定代表人:王季雷
董事:俞建忠、王
经营范围:开发、生产家用电器、电子、电机、电工产品、电动机具、自动控制设备、健身器械、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射极组件、微处理器、LED照明、半导体LED照明、大功率LED照明、LED显示屏产品、现代办公用品、通讯设备及其零部件（不含移动通信设备及相关管理部门审批方可生产的产品）、开发、生产上述产品相关的控制软件、设计制造与上述产品相关的材料；上述产品的技术服务；销售本公司生产的产品并进行售后服务；LED芯片的进口与贸易。

- 本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1.LED封装芯片项目、LED芯片封装项目的背景
我国已成为全球LED产业规模最大、增速最快的地区之一。2000年至2006年，我国LED产业年增长率在15%左右，2007年至2011年累计增幅超过222.98%。根据高工LED产业研究所统计数据，2012年我国LED行业总产值达到2,069亿元，2014年LED行业产值达到3,445亿元，年均复合增长29.35%；2014年上游外延芯片、中游封装、下游应用的规模分别为120亿元、568亿元、2,767亿元，分别同比增长42.86%、20.08%、23.28%。目前，国内芯片产业产值占比较低，其次为封装，应用环节占比最大。这跟中国LED企业在产业链上分布不均衡、由于资金和技术壁垒的阻碍，国内芯片规模受限，中上游外延片和芯片制造的主要核心技术集中在日本、德国、美国、韩国等，从而垄断了高端产品市场，预计未来国内LED芯片及封装产业将有巨大的作为。

在LED行业快速发展的同时，LED芯片技术发展优势已经确立。目前呈“LED封装芯片和封装器件”的“家中，Philips是一直在走传统技术路线；Cree和Osram目前一直在走垂直技术路线，LED芯片和封装器件的老大Nichia目前一直走传统技术路线，现在都不约而同地走向了倒装技术路线上。基于倒装LED芯片和封装器件的技术趋势，以及国内大厂的技术路线选择，充分说明了LED倒装芯片和封装器件系未来技术趋势，系LED终端应用的主流化方向。

Philips从2010年-2020年，LED照明的产品销量平均每年增6%，至2015年达到50%，2020年达到90%。本次募集资金项目的建成投产将有助于公司(备注LED—L)实现LED行业技术提升，提高公司的生产能力和盈利能力，促进LED行业产业升级，进一步完善产业结构，实现做大做强愿景。

- 补充流动资金
（1）LED行业普遍营业收入增长快，对流动资金需求较大
LED行业对流动资金的需求量越来越大，从业务领域涉及整个LED产业链的上游公司（三安光电、海洲明润、华灿光电、乾芯光电、鼎上光电）的实际情况来看，普遍应收账款回笼时间较长（2014年海洲明润应收账款周转天数为136天），存货采购和储备的资金占用较大（2014年度平均存货周转天数为125天），随着公司LED业务规模的扩大，预计公司对流动资金的需求将产生一定的缺口。
- （2）公司业务规模的持续扩张，需要进一步补充流动资金
最近三年公司的营业收入分别为275,763.78万元、312,989.35万元、415,473.36万元，同比增长135.0%、32.74%，随着LED项目建设项目的陆续建成和达产，公司的业务规模将进一步扩大。为了保持公司品牌和市场优势，进一步做大做强LED产业，公司未来需要补充流动资金支持业务发展。

- 本次非公开发行的背景的目的
（一）LED封装芯片项目、LED芯片封装项目的背景
我国已成为全球LED产业规模最大、增速最快的地区之一。2000年至2006年，我国LED产业年增长率在15%左右，2007年至2011年累计增幅超过222.98%。根据高工LED产业研究所统计数据，2012年我国LED行业总产值达到2,069亿元，2014年LED行业产值达到3,445亿元，年均复合增长29.35%；2014年上游外延芯片、中游封装、下游应用的规模分别为120亿元、568亿元、2,767亿元，分别同比增长42.86%、20.08%、23.28%。目前，国内芯片产业产值占比较低，其次为封装，应用环节占比最大。这跟中国LED企业在产业链上分布不均衡、由于资金和技术壁垒的阻碍，国内芯片规模受限，中上游外延片和芯片制造的主要核心技术集中在日本、德国、美国、韩国等，从而垄断了高端产品市场，预计未来国内LED芯片及封装产业将有巨大的作为。
- 在LED行业快速发展的同时，LED芯片技术发展优势已经确立。目前呈“LED封装芯片和封装器件”的“家中，Philips是一直在走传统技术路线；Cree和Osram目前一直在走垂直技术路线，LED芯片和封装器件的老大Nichia目前一直走传统技术路线，现在都不约而同地走向了倒装技术路线上。基于倒装LED芯片和封装器件的技术趋势，以及国内大厂的技术路线选择，充分说明了LED倒装芯片和封装器件系未来技术趋势，系LED终端应用的主流化方向。
- Philips从2010年-2020年，LED照明的产品销量平均每年增6%，至2015年达到50%，2020年达到90%。本次募集资金项目的建成投产将有助于公司(备注LED—L)实现LED行业技术提升，提高公司的生产能力和盈利能力，促进LED行业产业升级，进一步完善产业结构，实现做大做强愿景。

- 补充流动资金
（1）LED行业普遍营业收入增长快，对流动资金需求较大
LED行业对流动资金的需求量越来越大，从业务领域涉及整个LED产业链的上游公司（三安光电、海洲明润、华灿光电、鼎上光电）的实际情况来看，普遍应收账款回笼时间较长（2014年海洲明润应收账款周转天数为136天），存货采购和储备的资金占用较大（2014年度平均存货周转天数为125天），随着公司LED业务规模的扩大，预计公司对流动资金的需求将产生一定的缺口。
- （2）公司业务规模的持续扩张，需要进一步补充流动资金
最近三年公司的营业收入分别为275,763.78万元、312,989.35万元、415,473.36万元，同比增长135.0%、32.74%，随着LED项目建设项目的陆续建成和达产，公司的业务规模将进一步扩大。为了保持公司品牌和市场优势，进一步做大做强LED产业，公司未来需要补充流动资金支持业务发展。

- 本次非公开发行的背景的目的
（一）LED封装芯片项目、LED芯片封装项目的背景
我国已成为全球LED产业规模最大、增速最快的地区之一。2000年至2006年，我国LED产业年增长率在15%左右，2007年至2011年累计增幅超过222.98%。根据高工LED产业研究所统计数据，2012年我国LED行业总产值达到2,069亿元，2014年LED行业产值达到3,445亿元，年均复合增长29.35%；2014年上游外延芯片、中游封装、下游应用的规模分别为120亿元、568亿元、2,767亿元，分别同比增长42.86%、20.08%、23.28%。目前，国内芯片产业产值占比较低，其次为封装，应用环节占比最大。这跟中国LED企业在产业链上分布不均衡、由于资金和技术壁垒的阻碍，国内芯片规模受限，中上游外延片和芯片制造的主要核心技术集中在日本、德国、美国、韩国等，从而垄断了高端产品市场，预计未来国内LED芯片及封装产业将有巨大的作为。
- 在LED行业快速发展的同时，LED芯片技术发展优势已经确立。目前呈“LED封装芯片和封装器件”的“家中，Philips是一直在走传统技术路线；Cree和Osram目前一直在走垂直技术路线，LED芯片和封装器件的老大Nichia目前一直走传统技术路线，现在都不约而同地走向了倒装技术路线上。基于倒装LED芯片和封装器件的技术趋势，以及国内大厂的技术路线选择，充分说明了LED倒装芯片和封装器件系未来技术趋势，系LED终端应用的主流化方向。
- Philips从2010年-2020年，LED照明的产品销量平均每年增6%，至2015年达到50%，2020年达到90%。本次募集资金项目的建成投产将有助于公司(备注LED—L)实现LED行业技术提升，提高公司的生产能力和盈利能力，促进LED行业产业升级，进一步完善产业结构，实现做大做强愿景。

本次募集资金项目达产后，公司产业链得到了升级、优化，为抓住LED照明应用的风口打下了坚实的基础。

- 巩固产业链结构，进一步优化上下游产业链条
近年来，国内LED“商粉外片大圆弯，布局LED照明”。以三安光电、华灿光电为例，三安光电2007年通过资产重组整合LED外延片及芯片业务，2010年、2014年定增募资外延片、芯片项目，2015年再次定增募资LED外延片项目等；2013年至今年先后与鼎上光电、阳光照明、奇理光电等多家合资布局LED封装、应用；华灿光电先后布局“LED外延片及芯片二期项目”、“LED外延片芯片二期项目”，同时通过香港全资子公司HC SEMITEK LIMITED认购韩国株主会社Semicon Light 新发行股票，打通国际市场，加强技术合作。

国内“商粉LED产业链”的分布格局，预示着未来LED产业的竞争以产业链建设为核心，LED产业整合势在必行。公司本次募股项目为LED封装芯片项目、LED芯片封装项目，国内尚处空档期，募投项目的实施将有利于LED 芯片、封装的产业升级，进一步完善公司产业链结构。

（3）完善资本结构，控制银行借款规模，提高融资能力
截至2015年3月31日，公司的负债总额约为720,513.74万元，资产负债率高达55.03%，相比2014小家上市公司（九鼎股份、伊泰通、苏泊尔、奥申伯）均值均为41.15%，2014年LED上市公司（三安光电、澳瀚光电、华灿光电、乾芯光电、鼎上光电）均值均为33.07%，公司资产负债率明显较高。2012年至2014年财务费用分别为6,562.00万元、22,269.18万元、26,861.56万元，费用占比分别为3.10%、7.11%、6.47%，财务费用占比比较高，侵蚀公司盈利能力。

本次募集资金项目补充流动资金将有助于控制银行借款规模和财务费用，保障公司盈利能力。以公司2013年发行公司债券利率计算（5.95%），补充10亿元流动资金可节约5,960万元财务费用，提高公司盈利能力。

三、发行对象及其与公司关系

本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者和其他机构投资者，个人投资者等不超过10名（含10名）。特定投资者，证券投资基金管理人管理的全部以上基金认购时，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份，其中单个认购对象及其关联方一致行动人认购数量合计不超过25,000万股，超过部分的认购为无效认购。

本次非公开发行拟发行对象与公司不存在关联关系。具体发行对象将在取得发行核准批文后，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。

- 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期
（一）非公开发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
- （二）发行方式和定价原则
本次非公开发行全部采用定向对象非公开发行的方式进行，并在中国证监会核准批文有效期内选择适当时机发行。

本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第十一次会议决议公告日（即2015年6月13日），根据发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%的规定（定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），本次发行价格定为不低于11.89元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次发行价格将作相应调整。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照相关法律法规的规定和监管部门的的要求，根据竞价结果由公司董事会议与保荐机构（主承销商）协商确定。

- （三）发行数量
本次非公开发行的发行数量不超过37,847万股（含37,847万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将按中国证监会规定发行募集资金总额与除权（除息）后的发行价格作相应调整。在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际询价与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
- （四）限售期
本次非公开发行的股票在发行结束之日起12个月内不得转让。
- （五）本次非公开发行股票所募资金未分配利润的安排
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

序号	项目名称	计划投资（万元）	拟用募集资金投入（万元）
1	LED封装芯片项目	260,000	200,000
2	LED芯片封装项目	150,000	150,000
3	补充流动资金	100,000	100,000
	合计	500,000	450,000

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，不足部分由公司自筹解决。

在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行股票募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

- 六、本次发行涉及关联交易
公司本次发行股票募集资金不构成关联交易。
- 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化
本次非公开发行前，公司控股股东为芜湖德豪投资有限公司，持有公司315,356,800股，占股本的22.58%，公司实际控制人王季雷先生持有芜湖德豪投资有限公司90%的股份，通过芜湖德豪投资有限公司控制发行22.58%的股权比例；实际控制人的王季雷先生直接持有公司34,406,400股股份，占总股本的2.46%；芜湖德豪投资与一致行动人王季合持有公司349,736,200股股份，持股比例为25.05%。根据本次发行价格及定价，本次非公开发行股票数量的上限为37,847万股，其中单个认购对象及其关联方一致行动人认购数量合计不超过25,000万股，超过部分的认购为无效认购。若按发行37,847万股计算，本次发行后，芜湖德豪投资与一致行动人王季合合计持有公司股权比例将下降至19.71%，仍处于相对控股地位，因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
- 八、本次非公开发行的审批程序
本次非公开发行相关事宜已于2015年6月12日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。本次非公开发行经股票募集事项将本公司股东大会审议通过；本次非公开发行股票需取得中国证监会的核准。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

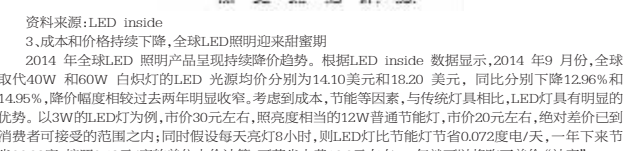
- 一、募集资金使用计划
公司计划本次非公开发行股票募集资金主要用于以下项目：

序号	项目名称	计划投资（万元）	拟用募集资金投入（万元）
1	LED封装芯片项目	260,000	200,000
2	LED芯片封装项目	150,000	150,000
3	补充流动资金	100,000	100,000
	合计	500,000	450,000

- 在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行股票募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。
- 二、LED倒装芯片项目、LED封装项目的具体情况
（一）项目实施的背景及必要性
1.我国LED行业进入快速发展时期
我国已成为全球LED产业发展最快速度地区之一。2000年至2006年，我国LED产业年增长率在15%左右，2007年至2011年累计增幅超过222.98%。根据高工LED产业研究所统计数据，2012年我国LED行业总产值达到2,069亿元，2014年LED行业产值达到3,445亿元，年均复合增长29.35%；2014年上游外延芯片、中游封装、下游应用的规模分别为120亿元、568亿元、2,767亿元，分别同比增长42.86%、20.08%、32.48%。目前，国内芯片产业产值占比较低，其次为封装，应用环节占比最大。这跟中国LED企业在产业链上分布不均衡、由于资金和技术壁垒的阻碍，国内芯片规模受限，中上游外延片和芯片制造的主要核心技术集中在日本、德国、美国、韩国等，从而垄断了高端产品市场，预计未来国内LED芯片及封装产业将有巨大的作为。

国家重大专项照明工程研发及产业联盟计划，至2015 年我国LED产业各环节累计规模将超过5,000亿元。

- 2.禁令令逐步实施，LED照明渗透率将成为一个风口
随着节能环保意识逐渐深入人心，各国政府对节能环保的重视，重视LED高效节能照明产品，制订了白炽灯的禁用的退出时间表，预计未来十年高耗能的白炽灯将退出历史舞台，大大刺激LED照明市场。根据LED inside最新发布的《2015全球LED照明市场趋势报告》显示，全球照明市场规模呈逐步上升的趋势，2015年全球照明市场规模将达到821亿美元，其中LED照明市场规模将达256.92亿美元，市场渗透率为31%，LED市场渗透率不断提高。



资料来源:LED Inside
3.成本竞争力持续提升，全球LED照明呈现加速趋密
2014 年全球LED 照明产品呈现持续降价趋势。根据LED inside 数据显示，2014 年9 月份，全球取代40W 600W 白炽灯的LED 光源均价分别为14.10美元和18.20 美元，同比分别下降12.96%和14.95%，降幅幅度超过过去两年同期营收。考虑到成本、节能等优势，与传统灯具相比，LED灯具有性价比优势。以3W的LED芯片，市价30元左右，照亮度相当12W普通灯泡，市价20元左右，绝对性价比已消费者可接受的范围之内；同时假设每天亮灯8小时，则LED灯比节能灯节约电0.072度/天，一年下来节电26.28度，按照48元/度的单位电价计算，可节省电费12.6元/年，一年就可以将购买差价“补齐”。

年份	2014年	占比	2015年	2016年	2017年
其中:中国收入	41,473.38	100.00%	619,341.70	646,177.12	811,471.40
营业收入	32,077.7		25,000	25,000	25,000
应收账款	8,401.29	1.99%	10,150.25	12,126.97	16,408.72
应收账款	146,595.65	36.34%	182,443.81	226,644.78	289,006.46
预收款项	4,818.14	1.06%	6,022.67	7,528.34	9,410.43
存货	128,985.24	31.11%	161,231.61	201,429.43	251,924.28
各项资产减值准备合计	288,159.68	69.64%	389,199.60	450,249.51	562,811.93
应付账款	66,499.28	1.63%	69,372.35	86,714.19	108,492.78
预收账款	98,996.26	2.41%	108,723.28	135,916.16	169,896.21
预收账款	8,373.78	1.79%	10,467.20	13,044.04	16,356.00
应付职工薪酬	6,798.48	1.59%	7,240.07	9,060.09	11,325.11
应交税费	-26,549.43	-0.76%	-35,711.79	-44,629.70	-56,009.78
各项负债合计	128,098.21	17.43%	160,107.76	200,134.70	260,168.38
流动负债合计(带息债务+经营性负债)	160,073.47	52.89%	200,091.64	250,114.80	312,643.51

根据上述测算结果，截至2017年，公司的流动资金占用金额为312,643.51万元，减去公司2014年末流动资金约160,073.47万元，公司需增加流动资金约152,570.03万元，该笔流动资金缺口需要通过留存收益、银行借款及股权融资等方式解决。目前公司资产负债率明显较高，2012年至2014年财务融资占用约6,562.00万元、22,269.18万元、26,861.56万元，费用占比分别为3.10%、7.11%、6.47%，财务费用占比比较高，侵蚀公司盈利能力。

- 三、本次发行募集资金使用计划
（一）本次发行募集资金使用计划
（二）本次发行募集资金使用计划
（三）本次发行募集资金使用计划

根据上述测算结果，截至2017年，公司的流动资金占用金额为312,643.51万元，减去公司2014年末流动资金约160,073.47万元，公司需增加流动资金约152,570.03万元，该笔流动资金缺口需要通过留存收益、银行借款及股权融资等方式解决。目前公司资产负债率明显较高，2012年至2014年财务融资占用约6,562.00万元、22,269.18万元、26,861.56万元，费用占比分别为3.10%、7.11%、6.47%，财务费用占比比较高，侵蚀公司盈利能力。

本次募集资金项目补充流动资金将有助于控制银行借款规模和财务费用，保障公司盈利能力。以公司2013年发行公司债券利率计算（5.95%），补充10亿元流动资金可节约5,960万元财务费用，提高公司盈利能力。

本次募集资金项目补充流动资金将有助于控制银行借款规模和财务费用，保障公司盈利能力。以公司2013年发行公司债券利率计算（5.95%），补充10亿元流动资金可节约5,960万元财务费用，提高公司盈利能力。

本次募集资金项目补充流动资金将有助于控制银行借款规模和财务费用，保障公司盈利能力。以公司2013年发行公司债券利率计算（5.95%），补充10亿元流动资金可节约5,960万元财务费用，提高公司盈利能力。

本次募集资金项目补充流动资金将有助于控制银行借款规模和财务费用，保障公司盈利能力。以公司2013年发行公司债券利率计算（5.95%），补充10亿元流动资金可节约5,960万元财务费用，提高公司盈利能力。

本次募集资金项目补充流动资金将有助于控制银行借款规模和财务费用，保障公司盈利能力。以公司2013年发行公司债券利率计算（5.95%），补充10亿元流动资金可节约5,960万元财务费用，提高公司盈利能力。

本次募集资金项目补充流动资金将有助于控制银行借款规模和财务费用，保障公司盈利能力。以公司2013年发行公司债券利率计算（5.95%），补充10亿元流动资金可节约5,960万元财务费用，提高公司盈利能力。

本次募集资金项目补充流动资金将有助于控制银行借款规模和财务费用，保障公司盈利能力。以公司2013年发行公司债券利率计算（5.95%），补充10亿元流动资金可节约5,960万元财务费用，提高公司盈利能力。

本次募集资金项目补充流动资金将有助于控制银行借款规模和财务费用，保障公司盈利能力。以公司2013年发行公司债券利率计算（5.95%），补充10亿元流动资金可节约5,960万元财务费用，提高公司盈利能力。

本次募集资金项目补充流动资金将有助于控制银行借款规模和财务费用，保障公司盈利能力。以公司2013年发行公司债券利率计算（5.95%），补充10亿元流动资金可节约5,960万元财务费用，提高公司盈利能力。

本次募集资金项目补充流动资金将有助于控制银行借款规模和财务费用，保障公司盈利能力。以公司2013年发行公司债券利率计算（5.95%），补充10亿元流动资金可节约5,960万元财务费用，提高公司盈利能力。

本次募集资金项目补充流动资金将有助于控制银行借款规模和财务费用，保障公司盈利能力。以公司2013年发行公司债券利率计算（5.95%），补充10亿元流动资金可节约5,960万元财务费用，提高公司盈利能力。

本次募集资金项目补充流动资金将有助于控制银行借款规模和财务费用，保障公司盈利能力。以公司2013年发行公司债券利率计算（5.95%），补充10亿元流动资金可节约5,960万元财务费用，提高公司盈利能力。

本次募集资金项目补充流动资金将有助于控制银行借款规模和财务费用，保障公司盈利能力。以公司2013年发行公司债券利率计算（5.95%），补充10亿元流动资金可节约5,960万元财务费用，提高公司盈利能力。

本次募集资金项目补充流动资金将有助于控制银行借款规模和财务费用，保障公司盈利能力。以公司2013年发行公司债券利率计算（5.95%），补充10亿元流动资金可节约5,960万元财务费用，提高公司盈利能力。

资金、银行贷款和非公开发行股票等先后芜湖、大连、扬州、蚌埠等地出资设立LED产品研发基地，从事LED芯片制造、LED封装和LED照明业务，进入LED产业链的中、下游。通过一定时间的技术投入人才储备，公司于2010年下半年开始涉足产业链上游的外延片领域，目前，公司已形成“外延片/芯片—封装—应用（灯具、显示屏生产和销售）/LED全产业链，形成小家电和LED照明及工业协同发展的业务格局。2012年至2014年公司分别收购鼎上照明27.03%的股权、华灿光电LED照明100%的股权。目前公司已基本完成了一体化产业链布局，基本形成了具有上游外延片、芯片、中游封装、下游照明、显示屏、背光等应用、销售的一体化产业链。

本次募投项目系公司LED产业链延伸上游外延片、芯片环节与中游封装环节，募投项目完成后，公司将充分利用产业链优势，优先满足自身生产经营计划，促进产销的良性循环。

2.逐步完善销售渠道体系，积极应对LED封装及应用的快速发展
根据Stratistics Unlimited统计数据，2014年全球LED封装收益超过150亿美元，预计2012-2018年间，全球LED封装收益年均复合增长率将达到13%；此外，照明市场将是LED应用的一个下风口，根据LED Inside统计，2012年全球LED照明市场规模达到104亿美元，其中，中国照明市场是仅次于欧洲市场的全球第二大照明市场，以中国市场为代表的新兴市场LED照明产品的普及将引领全球照明市场LED照明产品市场容量的增长。

LED封装、应用的快速发展系公司本次募投项目产能消化的保障。本次募投项目实施后，公司一方面将深耕传统现有客户需求，提高销售规模，同时利用现有客户化资源，销售渠道进行销售平台整合、业务拓展；另一方面将积极对雷士照明销售渠道的整合，大力拓展O2O照明及智能家居电商平台，实现线上线下融合，提高产品渗透率。

目前，德豪润达与雷士照明在天猫等都有各自的电商平台，并拥有“产供销”一体化系统。以雷士照明在中国拥有3000多家零售店为例，在互联网的推动下，未来将成为O2O电商“最后一公里”的平台，实现直接为终端消费者服务、设计和售后服务的功能。德豪润达的智能家居、雷士的照明业务，通过上述O2O平台将实现线上和线下的有机融合，进一步确保公司新增产能得以消化。

三、产业结构力度不断加强，市场逐步迈入厂商制
近年来，国内LED 芯片、封装产业加大了整合力度，小企业正在逐步退出，预计2015年这一趋势还将延续。LED 芯片封装技术快速发展，对资本投入和技术研发要求较高，2